

HEATPIPE SYSTEME **THERMISCHES MANAGEMENT**

FÜR GESTEIGERTE EFFIZIENZ
THERMISCH OPTIMAL



HEATPIPE SYSTEME

THERMISCHES MANAGEMENT

FÜR GESTEIGERTE EFFIZIENZ UND THERMISCH OPTIMAL

HALA **MODULARE AUFBAUTECHNIK**

HALA Hochleistungs-Kontakt-Interfacematerialien

Phase Change Filme

- TPC-Y-PC
- TPC-W-PC
- TPC-T-AL-CB
- TPC-R-AL

Grafit Folie

- TFO-S-CB

Grafit Folie / pyrolytisch

- TFO-Y-PG
- TFO-ZS-PG

Silikon Folie

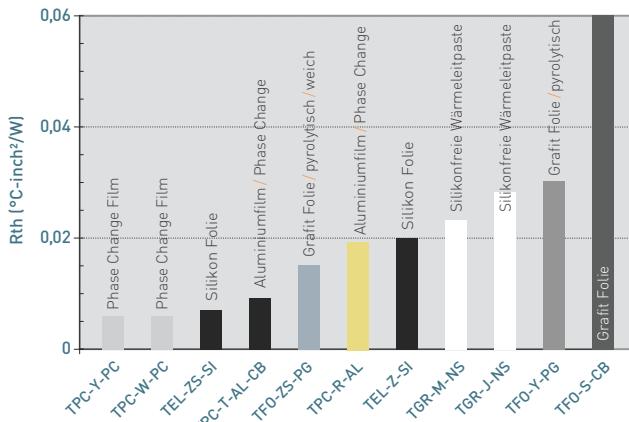
- TEL-Z-SI

TEL-ZS-SI**Silikon Wärmeleitpaste**

- TGR-S-SI

Silikonfreie Wärmeleitpaste

- TGR-J-NS
- TGR-M-NS

**RTH WERTE****EFFEKTE**

- Maximaler thermischer Kontakt
- Minimaler Wärmewiderstand
- Mechanischer Toleranzausgleich
- Verbesserter Wirkungsgrad

VORTEILE

- Erhöhte Langzeitzuverlässigkeit
- Homogene Temperaturverteilung
- Trockene Aufbringung